

株式会社弘和テック

逆境を変革の契機に。60年以上磨き続けた切削技術を武器に、成長産業へ果敢に挑戦

「受け身のままでは中小企業は生きていけない。ものづくりを極めて変化する社会のニーズに柔軟に対応しながら常に攻めの姿勢を持つことで、顧客にとっても従業員にとっても魅力ある会社を作る。（代表取締役 林 俊信氏）」

○事業展開の背景、効果・反響

- ・1965年包装機部品メーカーとして創業。工作機械や半導体製造装置などの部品加工にも事業拡大していた矢先、リーマンショックにより売上げが大幅に落ち込んだ。
- ・生き残りをかけ、ボーイング787の国内での部品生産が始められて間もない航空宇宙産業への本格参入を決意。現場からの反発など痛みを伴いながらも、国際基準に沿った工程ルール等を社内整備し、JISQ9100認証を取得。
- ・独自の治具・刃具設計で難削材を切削加工する高度な技術力や徹底したトレーサビリティ管理により、航空機業界からの信頼を得て受注を獲得し、危機を乗り越えた。
- ・2020年、新型コロナによる影響が航空業界を直撃。航空機需要の低迷により、メーカーにおける生産計画の見直しのため部品需要が減少し、経営に大きな影響が生じた。そこで生産ノウハウや航空業界で培った技術力を活かし、成長産業である半導体製造装置のロボット部品等の生産を拡大。電解研磨や精密機械による高度なヘール加工など特殊な加工にも対応し、現在は航空宇宙分野とともに主力事業にまで成長した。

○今後の展開

- ・脱属人化に向けた生産管理ソフトを自社開発し、品質や納期の管理体制を一層強化しつつ、海外顧客の新規開拓など需要が見込める新規分野への進出を目指す。



航空機部品の加工事例（材質:インコネル718）
※エンジンケース・トライアル加工実績
航空機は材質・形状ともに難削材が多く、加工には高い技術力を要する。
（出所:(株)弘和テックHP(<https://www.kouwa-tec.co.jp/aerospace>))



半導体部品の加工事例
（材質:SUS316L）
（出所:(株)弘和テックHP(<https://www.kouwa-tec.co.jp/semiconductor>))



半導体部品の加工事例（ヘール加工）
機械により精密加工を行うことで、手作業による精度のバラツキを避けつつ高い機密性を実現する。
（出所:弘和テックHP(<https://www.kouwa-tec.co.jp/semiconductor>))

<企業情報>

所在地 : 愛知県あま市富塚布内13番地

代表者 : 代表取締役 林 俊信

創業 : 1965年

従業員数 : 31名程度

資本金 : 1,000万円

事業内容 : 輸送機械器具製造業

HP : <https://www.kouwa-tec.co.jp/>